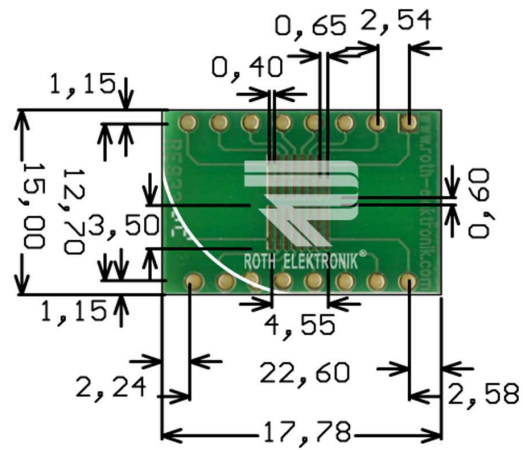


#### RE933-03ST

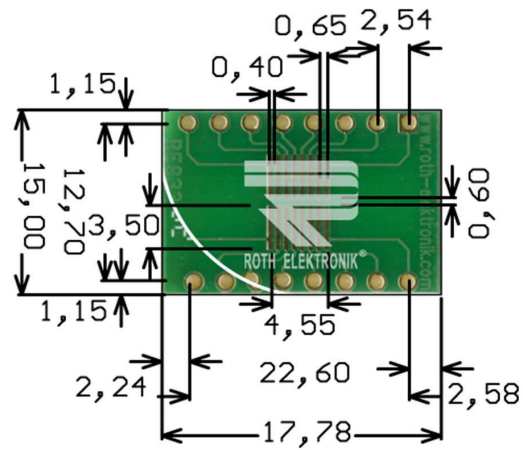
- Epoxy fibre-glass FR4 1.50 mm
- Double-sided 35 µm Cu
- Plated through holes (PTH)
- Surface chem. Ni/Au with solder stop mask
- Adaption circuit board for TSSOP 16 designed in a single row
- Pitch: 0.65 mm (173 mil)
- Hole diameter 1.00 mm
- Size 15.00 x 22.60 mm



#### RE933-03ST

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionsplatine für TSSOP 16 einreihig ausgeführt
- Pitch: 0,65 mm (173 mil)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 15,00 x 22,60 mm





#### RE933-03ST

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Adaptador para TSSOP 16 introducida en una línea
- Pitch: 0,65 mm (173 mil)
- Diámetro de agujeros 1,00 mm
- Tamaño 15,00 x 22,60 mm